

SHIELD FINGER**シールドフィンガー 1312**

注記) 5 ページ以降日本語版

1. Scope

This specification applies to the SHIELD FINGER 1312 which is used for grounding terminal between a printed wiring board and a metal frame.

2. Relevant Standards

The standards below are applicable as part of this specification.

JIS (Japanese Industrial Standard)

3. Types

Cat. No. : 1447009-6 (旧 3400146)

4. Material

Contact: Beryllium Copper Alloy (JIS C1720R)

Plating: Gold Plate 0.05 μ m MIN. Over Nickel Plate

5. Shape and Dimensions

As per Drawing 1447009-6 (旧 C3100049)

6. TEST PROCEDURES AND PERFORMANCE

No.	Title	Test Procedures	Performance
6.1	Mechanical Performance		
6.1.1	Spring Capacity	Measure the spring force, after making 10 times flexion to take one's position at 2mm/min. speed.	As spring height 1.0 mm Spring Force: 0.1N (10gf) min.

No.	Title	Test Procedures	Performance				
6.2	Process Compatibility Requirements						
6.2.1	Solderability	<p>The solderability test shall be performed per JIS C0050.</p> <table border="1" data-bbox="524 504 1317 620"> <tr> <td data-bbox="524 504 1030 563">Melted solder Temperature</td> <td data-bbox="1030 504 1317 563">235 ± 5°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="524 563 1030 620">Immersion Time in Solder</td> <td data-bbox="1030 563 1317 620">2 ± 0.5 sec.</td> </tr> </table>	Melted solder Temperature	235 ± 5°C	Immersion Time in Solder	2 ± 0.5 sec.	<p>The solder tails shall have been covered with new solder over a minimum of 75% of the solderable area.</p>
Melted solder Temperature	235 ± 5°C						
Immersion Time in Solder	2 ± 0.5 sec.						

1. 適用範囲

本仕様書は、プリント基板とシャーシ部材等との接続に用いられるアース用金具、シールドフィンガー 1312 について規定する。

2. 適用規格

以下の規格を本仕様書の一部として適用する。

JIS (Japanese Industrial Standard: 日本工業規格)

3. 適用型番

本仕様書は、以下の製品型番に対して適用される。

製品タイプ	型番	旧型番
1312	1447009-6	3400146
1312-S	1437259-5	3400146
1312-A	1447360-8	3400146

※1312-S及び1312-Aは、1312とテーピング仕様のみ異なる。

4. 材質

金属材料 : JIS C1720R ベリリウム銅 (ミルハードン材)

メッキ : ニッケル下地金メッキ 0.05 μ m MIN. (前めっき)

5. 形状及び寸法

図面による。

図面番号: 1447009-6 (1312, 1312-A) (旧 C3100049)

1437259-5 (1312-S) (旧 C3100083)

6. 試験方法及び性能

番号	項目	試験方法	性能				
6.1	機械的性能						
6.1.1	バネ特性	<p>試料に図示の方向から所定のバネ高さまでたわみを繰り返し与え、試験後のバネ圧を測定する。</p> <table border="1" data-bbox="667 443 1122 531"> <tr> <td>繰返速度</td> <td>2mm/min.</td> </tr> <tr> <td>繰返回数</td> <td>10回</td> </tr> </table>	繰返速度	2mm/min.	繰返回数	10回	<p>バネ高さ1.0mmの時 バネ圧: 0.1N(10gf)min.</p>
繰返速度	2mm/min.						
繰返回数	10回						

番号	項目	試験方法	性能						
6.2	実装適合性								
6.2.1	半田付性	<p>JIS C0050に基づき、下記の条件で試験を行う。</p> <table border="1" data-bbox="622 363 1227 539"> <tr> <td>半田温度</td> <td>235±5℃</td> </tr> <tr> <td>半田浸漬時間</td> <td>2±0.5 秒</td> </tr> <tr> <td>フラックス</td> <td>NA-200</td> </tr> </table>	半田温度	235±5℃	半田浸漬時間	2±0.5 秒	フラックス	NA-200	<p>半田付け部の75%以上が新しい半田コーティングで覆われること。(破断面は除く)</p>
半田温度	235±5℃								
半田浸漬時間	2±0.5 秒								
フラックス	NA-200								

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)